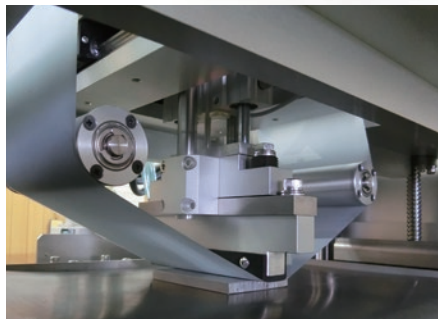


テープ研磨

砥石研削に比べて圧倒的な管理の簡単さ！
条件設定で誰でも同じように仕上げが可能！

テープ研磨装置は汎用のものがほとんどないため、ほぼ専用機となります。
砥石研削に比べて圧倒的に管理が楽で、条件さえ決めてしまえば誰でも同じように仕上げることが可能です。



平面研磨装置



光ファイバー研磨装置

高能率・低コスト

加工物により研磨フィルム巾を選択できるので、
高能率・低コストを実現。

容易なフィルム交換

簡単な操作による
研磨フィルムの交換で、目的に応じた
面粗さを得ることができます。

簡単操作

経験の多少に関わらず
精密仕上げが可能になります。

多様な研磨材

乾式・湿式の両用に使用できるとともに、
加工環境がクリーン&コンパクトです。

常に新しい砥粒面

テープを送りながら研磨するので、
常に新しい砥粒面で均一に
仕上げることが可能です。

多様な形状に対応

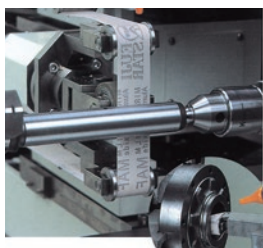
内径、外径、楕円形状ともに
精密仕上げ加工が可能です。

「テープ研磨」実用・加工事例



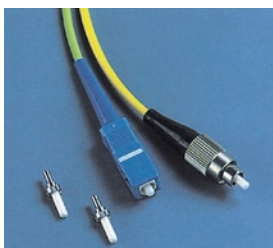
平面研磨

- FPDの全面加工
- カラーフィルター上の突起欠陥修正研磨
- 極薄基板のガラップ除去研磨
- セラミック基板の表面仕上げ研磨
- CD/DVDスタンパー原盤の表面研磨



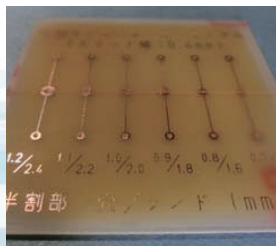
ロールシャフトの内・外径研磨

- 自動車エンジンクランクカムシャフトの内・外径研磨
- OAゴムローラー・樹脂ローラーの表面研磨
- マイクロモーターのコンピューターシャフト
- 外径研磨
- 自動車・油圧・精密・電気部品等の内外径研磨



異形部・曲面研磨

- フェルール端面の研磨 (PC研磨・SPC研磨)
- シャフト端球部の研磨
- 磁気ヘッドの研磨



プリント基板

- 樹脂部を研磨してパターンを露出



ロール・シャフト材

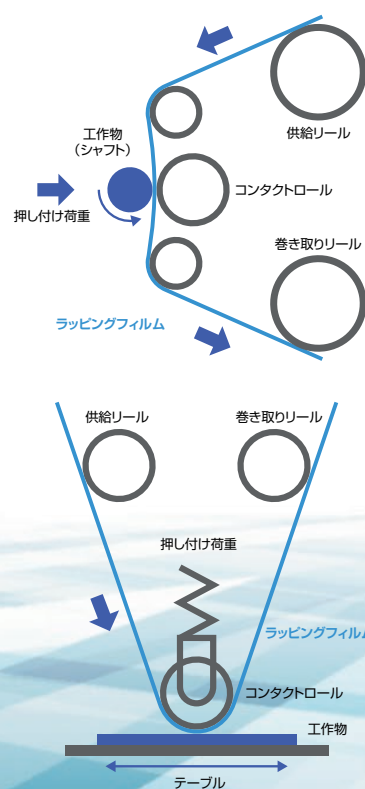
- 砥石で不可能な鏡面仕上げが可能



コイル材

- 不織布・ブラシでは取れないバリを除去

「テープ研磨」システムの仕組み



お客様の目的と製品に合わせて、マシンのカスタマイズが可能です！

製品の種類と粒度

製品名タイプ	砥粒	基材	ミクロン/製造粒度														形状									
			0.1	0.5	1	2	3	5	9	12	15	20	30	40	60	80	100	ロール	ディスク	シート	ベルト					
			20000	10000	8000	6000	4000	3000	2000	1500	1000	800	600	400	320	240	120									
ミラーフィルムMAF®	WA	75μ								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		100μ								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		125μ								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミラーフィルムMCF®	CC	75μ																			○	○	○	○	○	
		100μ								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		125μ								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミラーフィルムVAF®	WA	125μ							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミラーフィルムVCF®	CC	125μ																			○	○	○	○	○	
ミラーフィルムSAF®	WA	125μ							○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミラーフィルムDAF	WA	100μ																			○	○	○	○	○	
ミラーフィルムDCF	CC	100μ																			○	○	○	○	○	
ミラーフィルムFAF	WA	75μ																			○	○	○	○	○	
ミラーフィルムSDF	DIA	100μ																			○	○	○	○	○	
ラッピングフィルムLWF	WA	25μ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75μ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラッピングフィルムLGF	GC	75μ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラッピングフィルムLCF	CC	25μ								○	○											○	○	○	○	○
		75μ								○	○											○	○	○	○	○
ラッピングフィルムLDF	DIA	25μ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75μ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

砥粒:WA=白色酸化アルミナ DIA=ダイヤモンド CC=カーボラダム GC=グリーンカーボラダム 基材:25μ=1ミル 75μ=3ミル 100μ=4ミル 125μ=5ミル ※ノンスリップ加工
 *上記以外のサイズ、ベース厚のものも特注により加工します。 *VAF、LWF、LDFは粒度により基材の色が異なります。



プラストに使用するさまざまな研磨材を扱っております。お気軽にお問い合わせください。

三共理化学株式会社

■本社・工場 〒363-0021 埼玉県桶川市泉2丁目2番18号

TEL:048-786-2111(代) FAX:048-786-2793

http://www.sankyo-blast.com/

■SDソリューション開発・販売部

TEL:048-786-8017 FAX:048-786-8027

■営業所

本社、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡